

BASF の電子材料が半導体の微細加工を実現

2008 年 9 月 2 日

- 「セミコン台湾 2008」で、最新の微細加工プロセスソリューション、CMP、3D TSV を紹介

お問い合わせ：
BASF ジャパン株式会社
大倉 真紀
TEL: 03-3238-2341
FAX: 03-3238-2514
maki.okura@basf.com

化学業界の世界のリーディングカンパニーで、電子材料のサプライヤーとしても世界をリードする BASF(本社:ドイツ ルートヴィッヒスハーフェン)は 9 月 9 日から 11 日の 3 日間、台湾の台北世界貿易センターで開催される「セミコン台湾 2008」に出展し、半導体業界向けの最先端の化学ソリューションを幅広く紹介します。

BASF の電子材料事業部門ディレクター、バウター・ティエンは次のように述べています。

「半導体の開発分野では、回路線幅の微細化に向けた取り組みが継続しており、ナノレベルの開発が要求されています。エネルギー効率の高い最新の高性能チップの製造を実現するには、化学分野の高度なソリューションが必要不可欠です。BASF は、信頼性の高い高度なソリューションの提案を通してお客様の課題に取り組み、ビジネスの成功をサポートします。今回の展示会のテーマには『Committed to a Changing World』を選び、BASF の活動をアピールします」。

BASF は、さまざまな IC 製造プロセスに対応した革新的なソリューションを紹介します。以下はその一例です。

BASF ジャパン株式会社
コーポレート・コミュニケーションズ
住所: 〒102-8570
東京都千代田区紀尾井町 3-3
TEL: 03-3238-2341
FAX: 03-3238-2514
<http://www.japan.basf.com>

- **微細加工プロセス**: BASF の数年間の研究成果として、銅配線向けの填電気銅メッキや、無電解銅メッキなどのソリューションがあります。
- **化学的機械的研磨(CMP)**: 化学品と半導体の表面研磨に関するノウハウを活用することで、CMP プロセス向けの高度な酸化物スラリー、銅スラリー、バリアスラリーを開発しました。
- **3D スルーシリコンビア(TSV)**: BASF の 3D TSV ソリューションは、IC 業界やパッケージング業界が求める最も厳しい要件にも対応します。これらの製品は、銅ビア充填、銅ビア平坦化、メタルエッチング、接合材除去の各種プロセスに応用することが可能です。

上記に加えて、太陽電池業界向けの製品をはじめ、半導体業界向けにカスタマイズされた高温熱電対などを紹介します。

BASFについて

BASF(ビーエーエスエフ)は、「ザ・ケミカル・カンパニー(The Chemical Company)」を標語に掲げる世界の化学業界のリーディングカンパニーです。製品ポートフォリオは、石油・ガスから化学品、プラスチック製品、高機能製品、農業関連製品、ファインケミカル製品と多岐にわたります。信頼に応えるパートナー企業として、あらゆる業界のお客様のさらなる成功をサポートしています。BASFは、高付加価値製品と高度なソリューションの提供を通し、温暖化防止やエネルギー効率の向上、栄養改善、モビリティ向上などの世界的な課題の解決に重要な役割を果たしています。従業員数は9万5,000人超、2007年には約580億ユーロの売上高を計上いたしました。BASF のホームページアドレスは、www.basf.com、BASF ジャパンのホームページアドレスは、www.japan.basf.comです。